

CEOメッセージ



代表取締役社長・CEO

河合 利樹

ステークホルダーの皆さまには、平素よりご支援とご愛顧を賜り、心から感謝申し上げます。東京エレクトロンは1963年の創立以来、事業環境の変化に素早く対応しながら、時代をリードする独創的な技術で半導体産業の発展に貢献し、成長してまいりました。今日の当社があるのも、ひとえに皆さまのご支援のおかげでございます。当社は「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します」という基本理念の実践を通じ、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に取り組んでおります。

当社を取り巻く事業環境

近年の生成AIの登場に伴うAI利活用の一層の拡大に見られるように、デジタル技術と私たちの暮らしやあらゆる産業との関係は、これまでにないほど密接になっています。これに伴い、半導体の役割とその技術革新の重要性がますます高まっています。半導体デバイス市場は、2024年に約6,300億米ドル※1になりましたが、2030年頃には1兆米ドル※2程度の市場規模に達すると見込まれています。

一方、AIを駆使したさまざまなアプリケーションが今後誕生し運用されていくにあたり、高い情報処理能力が必要となることに加えて消費電力も増加していくことが予想されており、環境負荷の増大が危惧されています。そのため半導体には、高速、大容量、高信頼性に加え、低消費電力を実現する革新的な技術が必要とされています。半導体デバイスの技術革新には、付加価値の高い新装置と技術サービスが不可欠であり、当社が事業を展開する半導体製造装置市場は今後も大きく成長していくものと予想しております。

※1 出典: 世界半導体市場統計 (WSTS)

※2 当社による試算

ビジョンと中期経営計画

当社は、「半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社」というビジョンを掲げています。これは、「CSV」(Creating Shared Value)※3の考え方に基づいています。どのような状況でも経済活動が止まらない、強くしなやかな社会の構築に向けて、デジタル化と地球環境保全に向けた脱炭素化を支える半導体の技術革新に半導体製造装置メーカーとしての専門性を生かして貢献することを、当社として

のCSVすなわち“TSV”(TEL's Shared Value)と定め、社会的価値と経済的価値の創出に努めていきます。

ビジョンの実現に向けた中期経営計画として、当社は、2027年3月期までに、売上高3兆円以上、営業利益率35%以上、ROE30%以上を目指す財務目標を設定しております。米中対立や関税、ロシア・ウクライナ戦争や中東での紛争等の地政学的な動向、世界的なインフレなど、注視すべきリスクはありますが、未来に向けた半導体の重要性は変わりません。当社は、業界最大の装置出荷実績(累計96,000台以上※4)および業界最大の特許保有数(約25,000件※4)に基づく幅広い製品ラインアップを軸に、半導体のスケーリングと先端パッケージングの両領域において付加価値の高い新製品と技術サービスを提供することで、中期経営計画の達成を目指しております。

これに加え、当社の強みをさらに磨き、将来の成長機会を最大限に取り込むべく、2025年3月期からの5年間で研究開発投資1.5兆円以上、設備投資7,000億円以上、人材採用はグローバルで10,000名とする成長投資計画を設定し、取り組みを進めております。

※3 企業の専門性を活用して社会課題を解決することで、社会的価値と経済的価値を創出し、企業価値の向上と持続的な成長を実現するという考え方

※4 2025年3月末時点

人材に関する取り組み

当社では、「企業の成長は人。社員は価値創出の源泉」という考えのもと、社員が能力を最大限に発揮できるよう、社員の意欲と会社へのエンゲージメントを高めるため、次の5つのポイントからなる「やる気重視経営」に取り組んでいます。

CEOメッセージ

やる気重視経営の5つのポイントと主な取り組み

1 自分の会社や仕事が産業や社会の発展に貢献しているという実感をもてること
▶ TEL's Shared Value: デジタル化と地球環境保全に向けた脱炭素化を支える半導体の技術革新に貢献
2 会社の将来に対する夢と期待がもてること
▶ 中期経営計画に基づくワールドクラスの利益率の達成を当社グループ全体で追求
3 チャレンジできる機会があること
▶ ワールドクラスの利益に基づく積極的な研究開発投資をはじめとした成長投資の実施
4 成果に対する公正な評価とグローバルに競争力のある報酬
▶ ワールドクラスの営業利益に基づく業績連動報酬制度の採用
5 風通しの良い職場であること
▶ 社員集会や座談会をはじめとした社員と経営トップとのコミュニケーションの定期的な実施

また、「ONE TEL, DIFFERENT TOGETHER™」というスローガンのもと、3GすなわちGlobal (国籍)、Gender (性別)、Generation (世代) を意識しながら、人材の多様性の確保に取り組みとともに、ワーク・ライフ・バランスの向上、社員のキャリアパスに向けた施策や教育プログラムの充実化を進めています。

さらに、当社は、業界のリーディングカンパニーとして、将来の半導体産業を担う学生や研究者などの育成もミッションと捉え、積極的に取り組んでおります。日米の大学によって構成される「半導体の人材育成と研究開発に関する未来に向けた日米大学間パートナーシップ (UPWARDS※5)」に参画するなど、さまざまな産学連携プログラムの支援を通じ、次世代の半導体人材の育成に寄与することで、半導体産業のサステナブルな発展に貢献してまいります。

※5 UPWARDS: U.S.-Japan University Partnership for Workforce Advancement and Research & Development in Semiconductors

環境に関する取り組み

社会において地球環境保全の重要性がより一層高まる中、当社では、持続可能な社会の実現に貢献すべく、あらゆる事業活動を通じて環境負荷低減、とりわけ脱炭素化に取り組んでいます。当社は、2040年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする「ネットゼロ」目標を設定しています。その活動の一環として、全事業所における再生可能エネルギー使用比率100%を目指していますが、国内では2023年3月期に達成、グローバルにおいても89% (2025年3月期) まで進捗しています。

また、当社内のみならず、お客さまやパートナー企業さまと連携しながら、製品のライフサイクル※6全体について環境負荷低減を進めております。その一環として、環境にフォーカスしたイニシアティブ「E-COMPASS※7」を推進しており、サプライチェーン全体で半導体の技術革新と環境負荷低減に取り組んでおります。

※6 製品のライフサイクル: 製品の企画・開発・設計から、調達、製造、物流、お客さまにおける使用時、メンテナンス・サービス、廃棄までのバリューチェーン

※7 E-COMPASS: Environmental Co-Creation by Material, Process and Subcomponent Solutions

ガバナンスに関する取り組み

当社は、短期および中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指し、「“攻め”と“攻め”のガバナンス」を基本姿勢として経営をおこなっております。1つ目の“攻め”は、「“攻め”の事業活動」です。「利益は製品とサービスの価値の大きさを示す尺度」であると捉え、革新的な技術をもつBest Productsと付加価値の高いBest Technical Serviceの提供により、常にワールドクラスの営業利益率とROEを追求して

いきます。「“攻め”の事業活動」を推進するにあたっての重要事項として、当社では14項目のマテリアリティを特定し、優先して取り組んでおります。

2つ目の“攻め”は、「“攻め”の経営基盤構築」です。すべての企業活動の基本である、安全・品質・法令遵守や社員をはじめとするステークホルダーとのエンゲージメントやセキュリティの強化・向上などについても、当社の強みとすべく追求していきます。事業を遂行する上で直面し得るリスクとして16項目を特定 (2025年3月期に新たに4項目を追加) し、影響を最小化するのみならず事業機会にもしていくべく、適切なリスクマネジメントをおこなっています。

この「“攻め”と“攻め”のガバナンス」で、半導体の技術革新に貢献するとともに、地球に必要とされる真のグローバルエクセレントカンパニーを目指してまいります。

皆さまに愛され信頼される企業を目指して

半導体が実現する豊かな未来、進化し続ける半導体。それを支える製造装置市場は新たな成長フェーズに入りました。東京エレクトロンは世界No.1を目指して、これからも挑戦と進化を続け、当社だからできる付加価値の高い世の中にならない技術を創造し、社会に提供してまいります。そして、すべてのステークホルダーに愛され、高く信頼され、夢と活力のある会社であり続けられるよう努めてまいります。

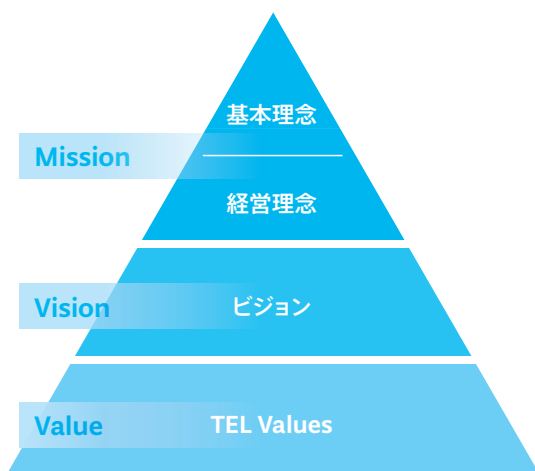
引き続き、皆さまのご支援を賜りたく、何卒よろしく願い申し上げます。

代表取締役社長・CEO

利樹

企業理念体系

東京エレクトロンの企業理念体系は、1963年の創業当時より今日に至る成長の中で、常に基本としてきた経営の考え方をまとめたものです。中長期的な視点から、企業としての使命とその実現に向けて大切にしている価値観や具体的な行動のあり方などを表し、Mission、Vision、Valueで構成されています。



Mission

基本理念 当社の存在意義 (Purpose) や社会的使命

最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します



経営理念 大切にすべき経営の規範

利益について

社会や産業の発展に貢献すべく、利益の追求を重視し企業価値の向上を目指します。

事業分野について

エレクトロニクスを中心とする最先端技術分野において、高品質な製品を提供し市場をリードします。

成長について

技術革新に常に挑戦し、事業拡大と市場創出により継続的な成長を図ります。

品質とサービスについて

顧客の満足と信頼を得るために真のニーズを理解し、品質とサービスの向上に努めます。

社員について

社員は価値創出の源泉であり、創造性と責任感と強いチームワークで情熱をもって業務に取り組みます。

組織について

個々の能力を最大限に発揮し、企業価値を最大化する最適な組織を築きます。

安全と健康と環境について

事業に関わるすべての人々の安全と健康、および地球環境への配慮を第一に考えて行動します。

企業の社会的責任について

企業としての社会的責任を自覚し、社会から高く評価され社員が誇りを持てる企業であるよう心がけます。

Vision

ビジョン 基本理念と経営理念に基づき中長期的に実現したい事業像

半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社

東京エレクトロンは、世の中の持続的な発展を支える半導体の技術革新を追求します。

当社の専門性を生かし、付加価値の高い最先端の装置と技術サービスを継続的に創出することで、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指していきます。

そして、企業の成長は人、社員は価値創出の源泉と位置づけ、ステークホルダーとのエンゲージメントを通じて、このビジョンの実現に向けて活動してまいります。

Value

TEL Values 社員一人ひとりが遵守すべき心構えや行動規範、価値観

誇り

私たちは、自らが誇りをもてる高い価値をもった製品・サービスを提供します。

オーナーシップ

私たちは、オーナーシップをもって、考え抜き、やり抜き、やり遂げます。

自覚

私たちは、社会の一員としての自覚をもち、責任のある行動をします。



TEL Valuesは、私たちが積み上げてきたものであり、これからも自分たちの手によって積み上げていくものです。

チャレンジ

私たちは、世界No.1を目指し、新しいこと、人のやらないことにチャレンジします。

チームワーク

私たちは、お互いを認め合い、チームワークを大切にします。

会社概要

当社は、半導体製造装置業界におけるリーディングカンパニーとしてグローバルに事業を展開しています。Best Products、Best Technical Serviceにより、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努めています。事業を通じてサステナブルな社会の構築と発展に貢献することで、基本理念を実践していきます。

拠点数 (2025年4月1日現在)

海外 20社・17の国と地域・65拠点

国内 6社・30拠点

合計 (連結) 26社※・18の国と地域・95拠点

※ 現在清算整理中の会社は地図上に表記していません

■ 本社 ■ 支社、事業所 (サービス拠点を含む)、営業所

沿革

1963

(株) 東京放送の出資により
(株) 東京エレクトロン研究所を設立



1964

米国サムコ社から拡散炉の輸入販売代理権を獲得し、販売を開始



1968

テル・サムコ(株)で拡散炉の国内生産を開始



1978

(株) 東京エレクトロン研究所から東京エレクトロン(株)へ商号変更

1980

東京証券取引所市場第二部に上場



1984

東京証券取引所市場第一部に指定替え



1986

半導体製造装置の輸出を開始

1990s

サービスや製造を担う会社の設立など国内グループ体制を強化、事業のグローバル化を推進するため世界各国に現地法人を設立

1990

フラットパネルディスプレイ製造装置市場へ本格参入

1994

海外での直接販売・サポート体制を開始

1999

東京証券取引所市場第一部における業種変更「商業」から「電気機器」へ

2006

行動規範として「TEL Values」制定

2007

人材開発強化のため「TEL UNIVERSITY」設立



2015

東京エレクトロン コーポレートガバナンス・ガイドラインを制定

新生TELとして再出発 (ビジョン、中期経営計画の策定、コーポレートロゴ刷新)

2021

統合報告書の発行を開始

2022

東京証券取引所プライム市場に指定替え



新たなビジョンと中期経営計画を策定

コーポレートメッセージとして Technology Enabling Lifeを制定

Technology Enabling Life

2023

創立60周年

売上高
2兆4,315億円
2025年3月期

(億円)
25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

1960s ~

技術専門商社として創業

1980s ~

本格的にメーカーへ移行

1990s ~

グローバル化を加速

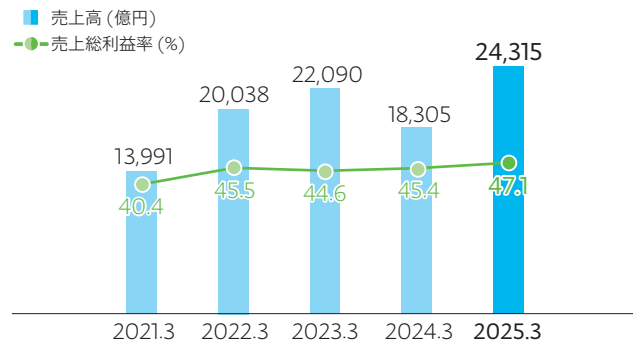
2000s ~

イノベーションと成長を志向

継続的な企業価値の向上に関する重要指標ハイライト

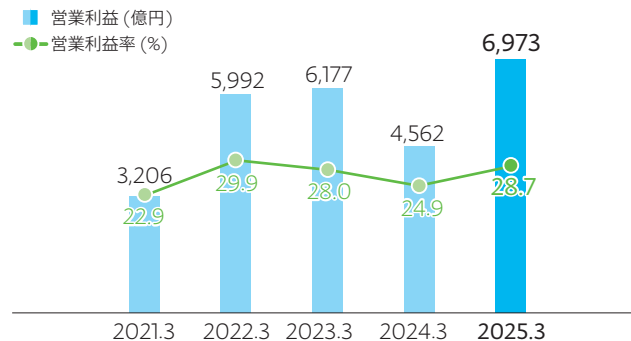
当社では、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上において重要である経営上の指標を明確にし、モニタリングや分析を実施することにより、事業活動における方針の決定やさまざまな判断をおこなっています。

売上高と売上総利益率



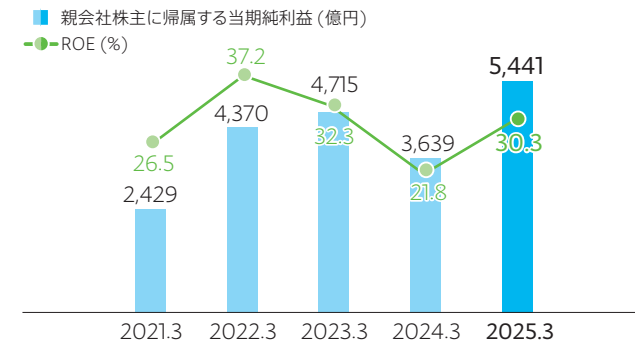
ロジック/ファウンドリおよびDRAM向けの活発な設備投資を背景に過去最高の売上高を達成。高利益率製品の売上比率増加が売上総利益率の向上に貢献

営業利益と営業利益率



将来の成長に向けた積極的な研究開発投資を進める一方で、過去最高の売上総利益率を達成し営業利益率が改善

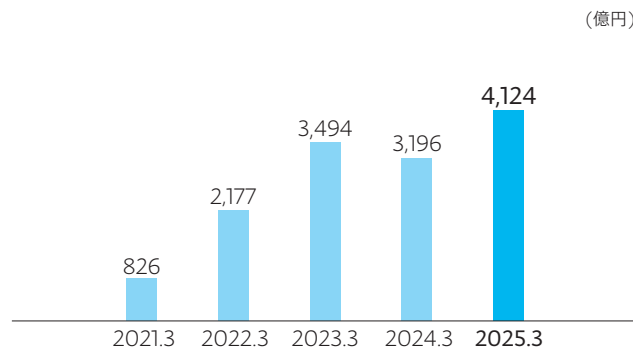
親会社株主に帰属する当期純利益とROE※1



利益率の改善と適切なバランスシート・マネジメントにより、中期経営計画の目標であるROE30%以上を達成

※1 ROE (自己資本利益率) = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期首・期末平均自己資本 × 100

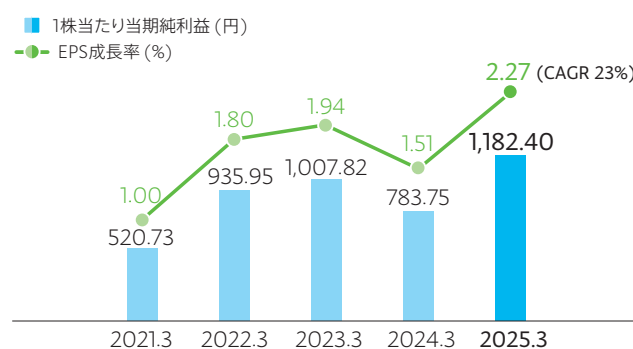
フリーキャッシュ・フロー※2



営業活動を通じた高水準のキャッシュ創出と将来の成長を見据えた成長投資の両立により、過去最高額のフリーキャッシュ・フローを記録

※2 フリーキャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー (定期預金および短期投資の増減を除く)

1株当たり当期純利益 (EPS)※3とEPS成長率※4

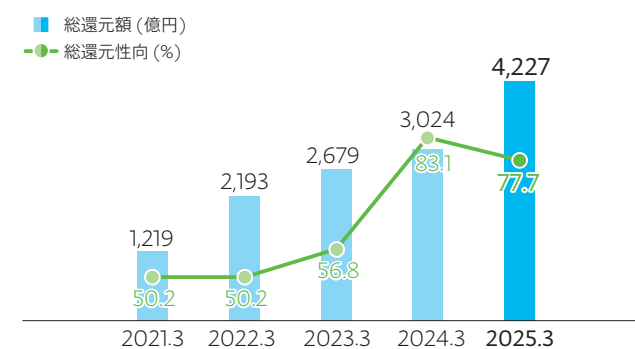


1株当たり当期純利益は着実な増加傾向にあり、年平均成長率 (CAGR) は23%

※3 2023年4月1日に実施した株式分割反映後の数値

※4 各期のEPS成長率は、2021年3月期を基準としたときの倍率を表示

総還元額と総還元性向



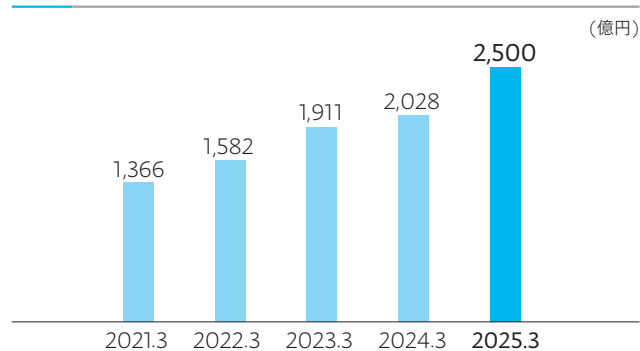
株主還元政策である配当性向50%※5に基づく配当金の支払いと2025年3月期に2度実施した自己株式の取得※6により総還元額は4,000億円超

※5 ただし、1株当たり年間配当金50円を下回らない。2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討

※6 自己株式の取得: 機動的に実施を検討

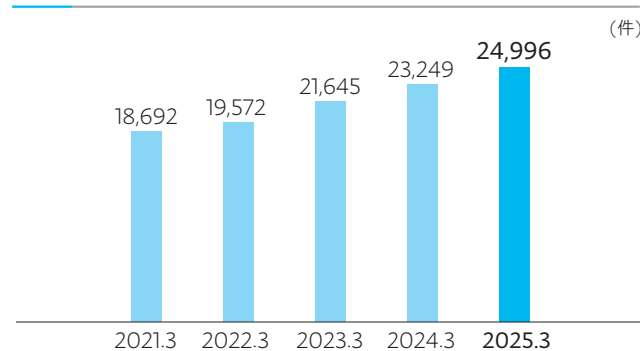
継続的な企業価値の向上に関する重要指標ハイライト

研究開発費



2025年3月期は前期比23.2%増加となる2,500億円の研究開発投資を実施。中期経営計画の目標である1兆円以上に対して順調に進捗。さらなる成長投資として、2025年3月期からの5年間で1.5兆円以上の研究開発投資を推進

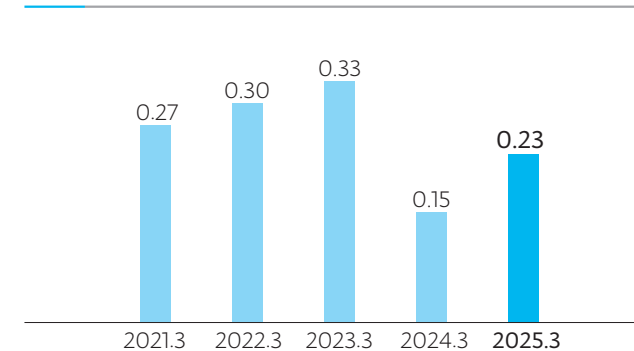
特許保有件数※1



2025年3月末時点の特許保有件数は24,996件であり、半導体製造装置業界でNo.1。量と質の両面で競争力のある知的財産権ポートフォリオを構築し、知的財産領域における優位性をグローバルレベルで維持

※1 2021年3月期~2022年3月期は社内データ、2023年3月期以降はLexisNexis® PatentSight+データに基づき作成

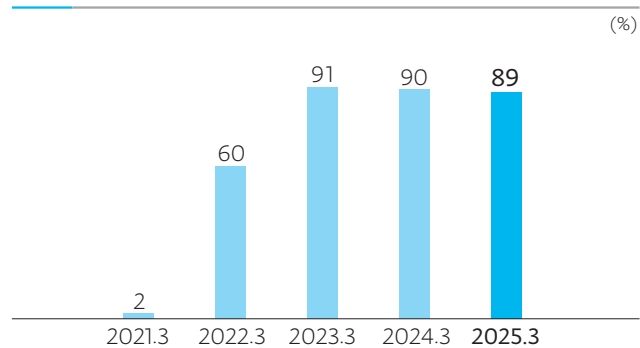
労働時間20万時間当たりの人身事故発生率 (TCIR※2)



2025年3月期は、安全教育の強化や装置安全設計への継続的な取り組みにより、半導体製造装置業界トップクラスの0.23を維持。「Safety First」をスローガンに中期経営計画の目標である0.10未満に向けたさまざまな活動を実施

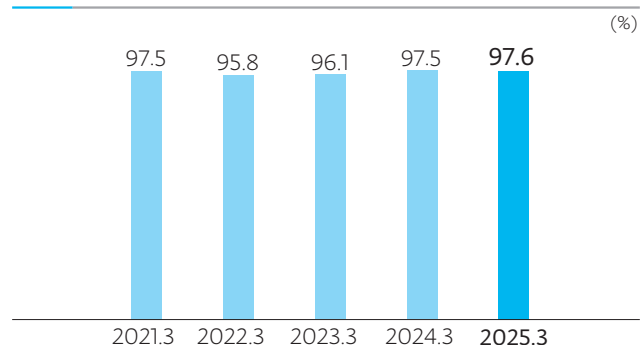
※2 TCIR: Total Case Incident Rate

事業所における再生可能エネルギー使用比率



2025年3月期の再生可能エネルギー使用比率はグローバルで89% (日本国内は100%)。アジア地域における導入を推進することで、2031年3月期までに使用比率100%を目指す

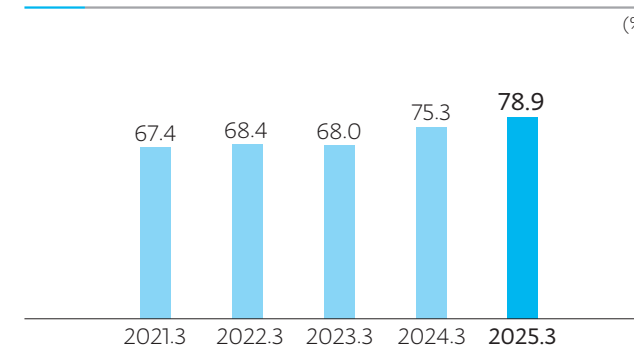
社員の定着率※3



2025年3月期はグローバルで97.6%の高い定着率を維持。社員が価値創出の源泉であるとの認識のもと、社員エンゲージメントのさらなる向上を目指して継続的かつ効果的に施策を展開

※3 離職率のデータを用いて算出

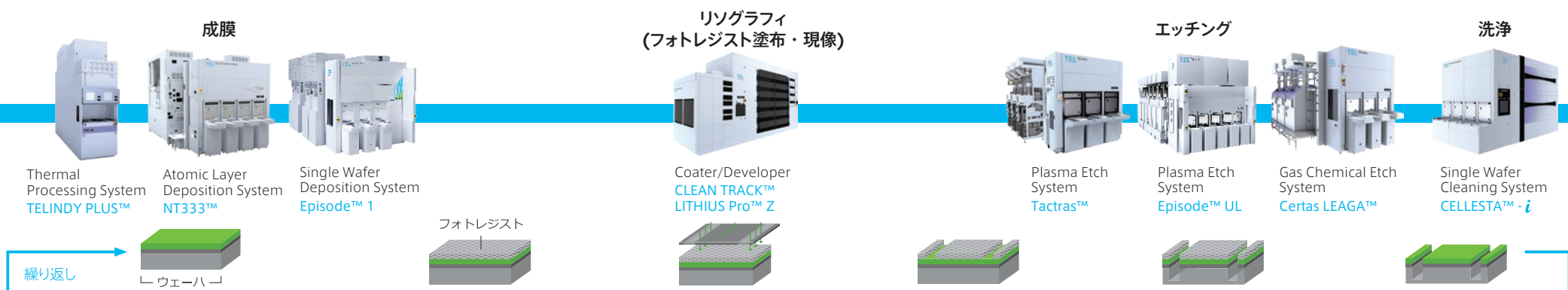
有給休暇取得率



2025年3月期はグローバルで78.9%の取得率。管理職には都度取得率を案内の上、業務配分の調整など個人として取得しやすい環境づくりを推進

半導体製造プロセスおよび当社の主要製品

■ ウェーハ処理プロセス (前工程) ■ 検査・組み立てプロセス (後工程)



酸化、CVD※1、あるいはALD※2法などを用いて、清浄なウェーハ上に薄膜（シリコン酸化膜、シリコン窒化膜、金属など）を堆積、成膜します。

※1 CVD: Chemical Vapor Deposition (化学気相成長)
※2 ALD: Atomic Layer Deposition (原子層堆積)

ウェーハを高速回転させながら、フォトレジストをウェーハ全面に薄く、均一に塗布します。

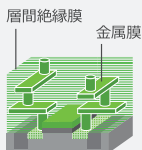
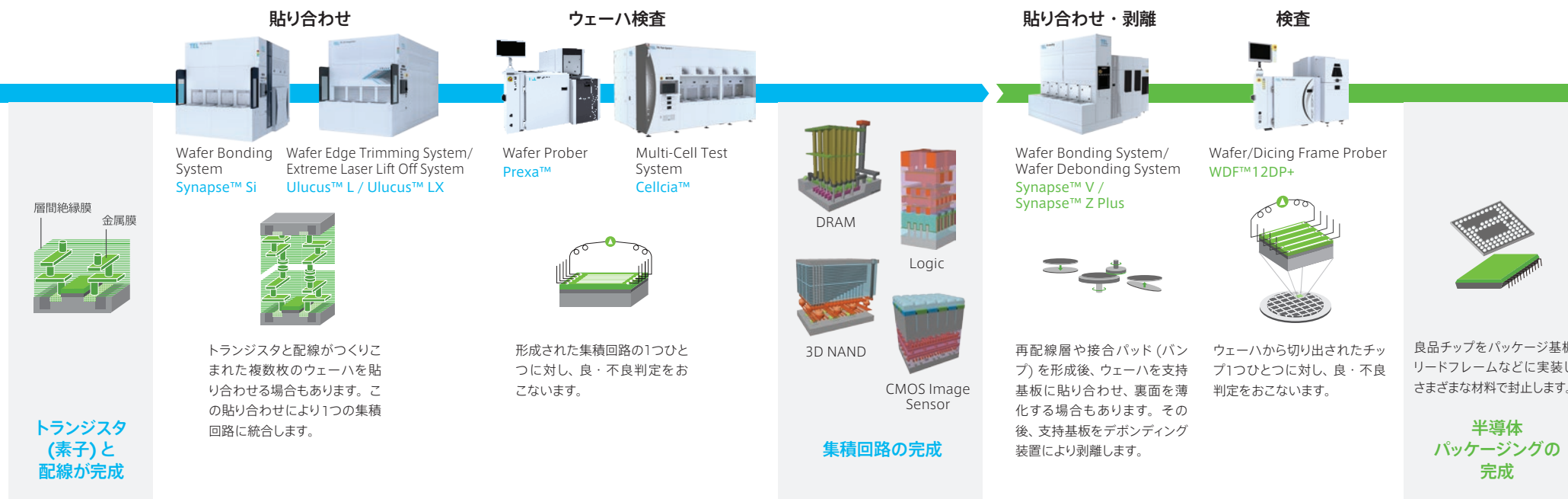
※3 フォトレジスト: UV光により性質変化が起こる感光材料

ICパターンを描いたフォトマスクをウェーハに合わせ、露光装置でUV光を照射し、フォトレジストにパターンを転写します。

露光されたフォトレジストを現像液で溶かします。これにより、使用したフォトマスクに応じたパターンがウェーハ上に残ります。

プラズマエッチング装置やプラズマレスのガスケミカルエッチング装置で、リソグラフィで形成されたパターンに従って、シリコン酸化膜・シリコン窒化膜・シリコンなどを所望の形状に削ります。

エッチング後に不要になったフォトレジストを除去します。また、洗浄装置でウェーハを薬液に浸して、不純物を除去します。



トランジスタ
(素子)と
配線が完成

トランジスタと配線がつくりこまれた複数枚のウェーハを貼り合わせる場合もあります。この貼り合わせにより1つの集積回路に統合します。

形成された集積回路の1つひとつに対し、良・不良判定をおこないます。

再配線層や接合パッド（バンパ）を形成後、ウェーハを支持基板に貼り合わせ、裏面を薄化する場合もあります。その後、支持基板をデボンディング装置により剥離します。

ウェーハから切り出されたチップ1つひとつに対し、良・不良判定をおこないます。

良品チップをパッケージ基板、リードフレームなどに実装し、さまざまな材料で封止します。

半導体
パッケージングの
完成